

무공해 Paste 도금 | ProConduct

| 제품 특징 |

- 간편한 스루홀 제작방법으로 화학용액 불필요
- 0.4mm 까지의 정확한 도금 처리 가능
- 도금의 전기적저항은 재료 두께에 따라 조금씩 다르지만 약 0.0192mΩ으로 매우 낮음
- 양면과 다층 기판을 포함하여 수 분 내에 완료 (열처리 과정 제외)



제품 규격

최대 재료 크기(X/Y)	229mm x 305mm(9" x 12")
최소 홀 직경	0.4 mm (15 mil) up to an aspect ratio of 1 : 4
도금 홀 수	제한 없음
최대 도금 층	4층
적용 시료	FR4, RF, and microwave materials
도금공정시간	약 35분
저항 값	평균 19.2mΩ, 표준 편차 7.7mΩ
Solderability	Reflow soldering < 250°C (482°F)
Option	Convection Oven Carrying Case



▶ LPKF ProConduct
Port no. 115790



▶ LPKF desktop vacuum table
Port no. 115878



▶ Hot-air oven
Port no. 115877



▶ LPKF desktop vacuum pump
Port no. 10033243